

## 導熱絕緣片 XK-K4



本產品取代絕緣片加塗散熱膏的傳統晶片安裝,可以乾淨,快速,高可靠度使用.

此系列產品使用導熱 polyimide 作為基材,表面為高導熱矽膠披覆,在極度要求絕緣環境下使用,由於 polyimide 的安定性與高抗壓能力,在絕緣與導熱達到完美平衡.

可取代 Bergquist Sil-Pad K4 系列

	unit	XK-K4	Method
Reinforcement Carrier		polyimide	visual
Color		Gray	
Thickness	mm	0.15	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm <sup>3</sup>	1.5	ASTM D792
Hardness	Shore A	90	ASTM D2240
Thermal impedance	°Cin <sup>2</sup> /W	0.53	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	0.8	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV	6	ASTM D149
Dielectric Constant	1	5	ASTM D150
Application temperature	°C	-50~180	
Tensile strength	psi	4000	ASTM D149
Elongation	%	40	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94